

115 年中鋼公司研究人員徵才啟事

本公司將招募研究人員，需求資格條件及人數如下表，歡迎符合資格條件且有意願者應徵報名。

◎報名日期：**即日起至 115 年 05 月 31 日 23:59 截止**，郵寄者以郵戳為憑(同仁親自持送相關文件者，收件期間同上)。

◎報名步驟：

- 1.請先至 google 表單(<https://reurl.cc/np7oyX>)進行線上報名(應徵代號至多以 2 組為限)。
- 2.線上報名完成後，請下載附件【中鋼公司研究人員應徵簡歷表】並將填寫完整之簡歷表併同下列各項指定之相關文件，以掛號寄送：「81233 高雄市小港區中鋼路 1 號，中鋼公司人力資源處任用組 A11 收」。(本公司同仁之親友如有興趣報名者，請轉知應徵者務必於上述報名期間先進行線上報名，線上報名完成後，相關文件可由同仁親自持送人力資源處任用組)



- 請依下載附件之電子檔案格式填寫，未依據該格式填寫者，視同初審不合格。
- 請於信封上註明：寄件人姓名、應徵代號。

◎檢具文件：

- 1.中鋼公司研究人員應徵簡歷表。
- 2.博/碩士畢業證書影本(註：應屆畢業生得報名，惟於面試時應提供應屆畢業學校出具之應屆畢業保證書；如於錄取進用時未繳驗畢業證書正本，將註銷錄取資格)；
- 3.博士、碩士及大學成績單(正本，各一份；若無攻讀博士則免附博士成績單)；
- 4.TOEIC 550 分以上或其他英文檢定證明文件影本(詳下表，至遲須於面試前提供)；如於英語系國家取得大學以上學歷者免附。

檢定名稱	成績分數
TOEIC	550 以上
IELTS	4 以上
TOEFL(紙筆型態 PBT)	457 以上
TOEFL(電腦型態 CBT)	137 以上
TOEFL(網路型態 iBT)	47 以上
全民英檢(GEPT)	中級初試通過以上
外語能力測驗(FLPT)	三項筆試總分：195 以上 口試：S-2 以上

- 5.博/碩士學位論文(平裝版；若無攻讀博士則免附博士學位論文)；
- 6.其他(得獎紀錄或文件)。

◎甄選程序：(請注意：第一至第三階段甄審結果，以 e-mail 通知為準。)

- 1.第一階段：文件初審
初審合格者，再通知參加後續各階段甄選程序
- 2.第二階段：複審
個別進行 30 至 40 分鐘之專題報告，複審合格者另通知面試。
- 3.第三階段：面試
面試合格者將以專函通知錄取、報到等事宜。

◎甄選未獲錄取者，所檢具之相關文件，本公司將統一於甄選過程全部結束後按通訊地址寄回。

◎服務時間：週一至週五 08:30~11:30、12:30~16:30

◎聯絡電話：(07)8051550 王小姐

◎115 年度研究人員進用需求統計表◎

應徵代號	工作內容	主修科系	博士	碩士	專業技能或經驗	需求人數
T11A	鋼鐵產品開發	材料、冶金、機械等相關科系	V	-	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉物理冶金、金屬熱處理、鋼鐵相變態、材料機械性質、界面反應控制等領域知識。 熟悉 SEM、XRD、EBSD、TEM、FIB、光學顯微鏡等儀器操作與材料分析能力。 具備鋼鐵材料開發、製程設計、組織與特性分析之相關研究經驗者尤佳。 	1
T12A	低排碳煉鋼技術研究	化工、材料、冶金等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 反應熱力學、反應動力學。 流力、熱傳或質傳模擬分析。 具反應熱力學/動力學計算專長、冶煉或鑄造技術研究經驗者尤佳。 	1
T12B	鋼鋁煉鑄製程智能化技術開發	材料、化工、機械、工業工程等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 流力、熱傳或質傳模擬。 物理冶金鑄造、物化反應製程智能化應用。 製程操作資料最佳化與大數據應用研發。 熟悉人工智慧應用相關技術尤佳。 	1
T15A	智慧軋延製程研究	機械、動機、航太、工科、系統工程等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 軋延製程研究與智慧製造開發 固體力學、數值力學或有限元素法、AI 數值預測 具 AI 深度學習、結合力學與智能化應用經驗佳 具 C++ 或 Python 程式編輯能力佳 	1
T15B	熱流製程研究	機械、動機、航太、工科、系統工程等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 製程熱流場解析與製程溫度控制。 工業熱流製程診斷。 工業熱流設備效能提升。 熟悉 CFD 分析軟體或撰寫熱傳計算模式。 具 C++、Python 程式編輯能力尤佳。 	1

應徵代號	工作內容	主修科系	博士	碩士	專業技能或經驗	需求人數
T18A	耐蝕產品評估與應用技術開發	材料、冶金、化工、化學等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉防蝕工程、電化學分析、材料物理冶金、環境誘發破裂等領域知識。 熟悉 SEM、XRD、EBSD、光學顯微鏡等儀器操作與材料分析能力。 具腐蝕性質評估及破損分析相關研究經驗者尤佳。 	1
T18B	熱處理應用技術開發	材料、冶金、化學、化工、機械等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉物理冶金、鋼鐵相變態、材料機械性質、熱傳等領域知識。 熟悉 SEM、XRD、EBSD、光學顯微鏡等儀器操作與材料分析能力。 具金屬熱處理相關經驗者尤佳。 	1
T18C	銲接應用技術開發	材料、冶金、機械等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉物理冶金、鋼鐵相變態、材料機械性質…等領域知識。 熟悉 SEM、XRD、EBSD、光學顯微鏡等儀器操作與材料分析能力。 具雷射銲接/切割或程控設定經驗者尤佳。 	1
T61A	碳材料產品開發與應用	化學、化工、材料及高分子等相關科系	V	-	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉材料力學、或高分子物理/化學、或表面化學。 熟悉 SEM、XRD、XRF、光學顯微鏡等儀器操作與材料分析能力。 具碳材料或粉末冶金開發經驗者尤佳。 	1
T62A	觸媒化工技術研究	化工、環工、化學、材料等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 化工製程、方法設計、單元操作。 流體、輸送現象、熱傳或質傳計算。 具工程技術開發、模擬分析經驗者尤佳。 	1
T66A	靶材與鈦、鎳合金產品與製程開發	材料、冶金、機械、物理、能源等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 熟悉材料物理冶金、機械性質及金屬塑性加工。 具微結構及缺陷分析能力。 具金屬冶煉/熱機加工經驗，或熟悉半導體、光電或綠能製程者。 具機器學習、有限元素法或計算冶金等相關材料模擬技術之研究經驗者尤佳。 	2

應徵代號	工作內容	主修科系	博士	碩士	專業技能或經驗	需求人數
T71A	AOI 與 AI 影像識別技術開發與應用	電機、資工 相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 具備影像分析及數值分析演算法開發能力。 具備光學及影像感測系統設計開發經驗。 熟悉 C/C++, C#, Python 程式語言。 	1
T71B	電動車馬達設計	電機、機械 相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 具馬達設計與開發之經驗。 具電機機械、磁特性分析、機構設計、馬達驅動經驗。 熟悉 JMAG、ANSYS MAXWELL、MotorCAD、MotorXP。 	1
T71C	智慧電網與馬達監診技術開發	電機相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 具電力系統模擬分析、微電網研究、及智慧電網設計之經驗。 具研究 AIoT 韌體開發、智慧感測、邊緣運算等應用之經驗。 熟悉 DIgSILENT、及 Python 尤佳。 	1
T72A	熱、電系統診斷與優化、熱回收，系統節能減碳技術開發、流體轉動機械設備能效改善	機械、航太、能源、工程技術等 相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 熱流解析、化學反應流場模擬。 燃燒或電加熱系統解析與優化。 葉輪/扇葉幾何設計、參數化建模、優化設計與性能分析 	1
T72B	碳捕捉與再利用製程模擬	化工、化學、機械、能源等相關 科系碩、博士	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 化工製程模擬與設計、碳捕捉與再利用等相關技術之研發。 熟悉 Aspen 化工製程模擬軟體。 具化工實務者優先。 	1
T72C	能源製程操作優化與智能化應用技術開發	化工、機械、電機、能源、資工 等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 製程設計、控制、模擬等相關技術之研發 製程操作較適化、智能化、數據分析等相關技術之研發 熟悉 Python、C# 程式語言或大數據資料分析且有具體成果者優先 熟悉水、氣、電等能源相關製程操作優化技術且有具體成果者優先 	1
T74A	機器人技術應用及系統研究	電機、電信、機械、控制、資工 等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> 具多感測器融合使用經驗。 具無人載具控制經驗。 熟悉 ROS 尤佳。 	1

應徵代號	工作內容	主修科系	博士	碩士	專業技能或經驗	需求人數
T74B	人工智慧技術開發	電信、電機、資工、資科、資管、統計、工業工程等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> ● 生成式 AI 模型與框架應用。 ● 混合雲 AI 應用敏捷式研發。 ● XAI 智慧決策與商業分析。 ● 智慧排程及最佳化技術研發。 	1
T74C	電腦視覺技術開發	電信、電機、資工、資科、控制、工業工程等相關科系	V	V	<ul style="list-style-type: none"> ● 生成式 AI 模型與框架應用。 ● 電腦視覺應用研發。 ● 數位訊號處理與自動控制技術。 ● 電腦網路與通訊技術。 	1
T75C	水處理開發	環工、化工、資工	V	V	<ul style="list-style-type: none"> ● 物理/化學廢水處理單元設計(吸附、沉澱、膜處理、氧化還原等)。 ● 製程用水處理、回收與水資源整合優化。 ● 具備應用 AI 於水處理數據分析、異常預測、操作參數優化、製程模擬與系統整合者尤佳。 ● 碩士(含)以上、博士尤佳。 	1

應徵類別代號：1. _____；2. _____。（請依個人志願之順位填列）

是否同意本次招募其它職位之徵選：同意 不同意

填表日期：____年____月____日

錄取後可報到日期：____年____月____日

個人資料：

姓名：_____ 性別：男 女

出生年日：____年____月____日 婚姻狀況：單身 已婚

兵役狀況：役畢 未役 免役(請補充說明)_____

國籍：_____

聯絡電話：_____ 手機：_____

E-mail: _____

含郵遞區號之通訊地址：() _____

請貼上
2吋半身
個人近照

學歷資料：

學歷別	校名	系所別	入學年月	畢業年月	學位
博士			/	/	
碩士			/	/	
大學			/	/	

在學平均成績：

學年別	第一學年		第二學年		第三學年		第四學年		第五學年	
學期別	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期	上學期	下學期
博士										
碩士										
大學										

專長能力：

專長領域	
電腦技能	
其他證照	

語文能力：(如有通過 TOEFL/TOEIC/IELTS/全民英檢及其他檢測合格者，請註明項目和成績)

語文別	聽	說	讀	寫	檢測項目及成績
英文					
日文					
其他					

工作經歷：(工作內容及離職原因請簡述，如無工作經歷可免填)

工作期間起迄	公司名稱	職稱	主要工作內容	離職原因
/ ~ /				
/ ~ /				
/ ~ /				

請依序附上下列之紙本資料：

一、基本資格審查必備文件：

1. 中鋼公司研究人員應徵簡歷表；
2. 博/碩士畢業證書影本(註：應屆畢業生得報名，惟於面試時應提供應屆畢業學校出具之應屆畢業保證書；如於錄取進用時未繳驗畢業證書正本，將註銷錄取資格)；
3. 博士、碩士及大學成績單(正本，各一份；若無攻讀博士則免附博士成績單)；
4. TOEIC 550 分以上或其他英文檢定證明文件影本(如於英語系國家取得大學以上學歷者免附)；
5. 博/碩士學位論文(平裝版；若無攻讀博士則免附博士學位論文)；
6. 其他(得獎紀錄或文件)。

二、自傳：(可用中文或英文撰寫，最多 2 頁為限)

三、應徵資格說明：

(請簡述：自我專長、符合應徵職務之理由、期望之工作內容、自我評價和期許，以 1 頁為限，格式不拘)

應徵職務之優先順序：1. _____ ； 2. _____ 。

(同時應徵 2 個工作職務者，請註明)

四、博士論文摘要：

(請簡述：緣由、目標、研究方法、重要研究結果與技術成就，最多 3 頁為限；若無攻讀博士則免附)

五、碩士論文摘要：

(請簡述：緣由、目標、研究方法、重要研究結果與技術成就，最多 3 頁為限)

六、國內外期刊及研討會論文發表清單：(請加註 EI/SCI)

七、國內外專利申請清單：(如無，可免填)

八、國內外得獎紀錄：(如無，可免填)

◎附件清單檢核表：(請依序排列下列資料，1-10 項為必備文件，11-15 項如無，請填“0”)

1. 中鋼公司研究人員應徵簡歷表_____份；
2. 博/碩士畢業證書(影本)_____份；
3. 博士、碩士及大學成績單(正本，各一份)_____份；
4. TOEIC 550 分以上或其他英文檢定證明文件(影本)_____份；
5. 博/碩士學位論文(平裝版)_____份；
6. 自傳_____份；
7. 應徵資格說明_____份；
8. 博士論文摘要_____份；
9. 碩士論文摘要_____份；
10. 具代表性之國內外期刊論文_____份(最多 3 ~ 5 份)；
11. 國內外專利證書影本_____份；
12. 國內外得獎證書影本_____份；
13. 電腦證照影本_____份(請依個人狀況填列)；
14. 役畢或免役證明(影本)_____份；
15. 其他證明文件_____份(請依個人狀況填列)。

